

厦门华侨电子股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准。公司本次重大资产重组能否获得上述核准通过，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 7 月 24 日开市起停牌。

经与有关各方论证和协商，该重大事项构成了重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 8 月 7 日起继续停牌，停牌期间公司已按照相关规定于每五个交易日公告重组事项进展情况。

公司于 2017 年 12 月 29 日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈厦门华侨电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其他相关议案，并于 2017 年 12 月 30 日披露了《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。

2017 年 12 月 30 日，公司发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的公告》，根据证监会和交易所相关规范性文件的要求，上海证券交易所须对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2018 年 1 月 2 日起继续停牌。

2018 年 1 月 16 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0076 号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实。但由于《问询函》涉及的内容较多，部分问题涉及的事项尚需进一步确认与完善，公司无法在 2018 年 1 月 26 日前完成《问询函》的回复。经公司申请，公司对《问询函》的回复公告将不迟于 2018 年 2 月 6 日披露。详见公司于 2018 年 1 月 26 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临

2018-007)。

截止本公告日，公司正积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并将与华西证券股份有限公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案出具的核查意见一并回复上海证券交易所。同时，相关各方亦积极推进本次资产重组的各项工作，待本次交易涉及标的资产审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的各项提案，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序和信息披露义务。

公司披露的《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次发行股份购买资产涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明。公司相关信息均以指定披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2018年1月29日